

79325-2024 - Ergebnis

Deutschland – Elektromechanische Ausrüstung – Beschaffung einer chemisch-mechanischen Polieranlage

OJ S 27/2024 07/02/2024

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft

E-Mail: ausschreibung@mpp.mpg.de

Rechtsform des Erwerbers: Organisation, die einen durch einen öffentlichen Auftraggeber subventionierten Auftrag vergibt

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Beschaffung einer chemisch-mechanischen Polieranlage

Beschreibung: Die Anlage soll geeignet sein, um Wafer mit verschiedenen topographischen Schichten, wie z.B. Silizium, Siliziumoxid, Wolfram, etc. zu planarisieren und zu polieren. Es muss sich um eine vollautomatische Anlage mit vollständiger Integration aller notwendigen Komponenten, wie Polier-, Reinigungs- & Trockeneinheit handeln, sogenanntes Dry in/Dry out. Aufgrund der Verwendung von doppelseitig prozessierten Wafern muss der Transport innerhalb der Anlage mit einem rückseitenschonendem Handlungssystem von Ein- zu Ausgabekassette erfolgen. Die einzelnen Prozessmodule müssen ebenfalls möglichst rückseitenschonend ausgeführt sein. Die Anlage muss zur Bearbeitung sowohl von 6- als auch 8-Zoll Wafern geeignet sein. Ein dazu eventueller Umbau muss vom Benutzer möglichst einfach durchführbar sein und darf nicht länger als 3 Arbeitstage in Anspruch nehmen. Die Anlage muss möglichst kompakt sein und darf wegen des vorhandenen Reinraumplatzes ein Flächenmaß von 2,5 x 2,5 m² nicht überschreiten. Eine Secs/Gem Schnittstelle muss vorhanden sein. Außerdem muss ein Barcodescanner mitgeliefert werden.

Kennung des Verfahrens: 3bdf426c-2ad0-4254-8df1-e7e34f019b40

Interne Kennung: 08-2024

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 31720000 Elektromechanische Ausrüstung

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Beschaffung einer chemisch-mechanischen Polieranlage

Beschreibung: Der Auftragnehmer hat eine chemisch-mechanischen-Polieranlage (CMP) für Wafer gemäß den nachfolgend beschriebenen Spezifikationen zu erstellen: Die Anlage soll geeignet sein, um Wafer mit verschiedenen topographischen Schichten, wie z.B. Silizium, Siliziumoxid, Wolfram, etc. zu planarisieren und zu polieren. Es muss sich um eine vollautomatische Anlage mit vollständiger Integration aller notwendigen Komponenten, wie Polier-, Reinigungs- & Trockeneinheit handeln, sogenanntes Dry in/Dry out. Aufgrund der Verwendung von doppelseitig prozessierten Wafern muss der Transport innerhalb der Anlage mit einem rückseitenschonendem Handlingssystem von Ein- zu Ausgabekassette erfolgen. Die einzelnen Prozessmodule müssen ebenfalls möglichst rückseitenschonend ausgeführt sein. Die Anlage muss zur Bearbeitung sowohl von 6- als auch 8-Zoll Wafern geeignet sein. Ein dazu eventueller Umbau muss vom Benutzer möglichst einfach durchführbar sein und darf nicht länger als 3 Arbeitstage in Anspruch nehmen. Die Anlage muss möglichst kompakt sein und darf wegen des vorhandenen Reinraumplatzes ein Flächenmaß von 2,5 x 2,5 m² nicht überschreiten. Eine Secs/Gem Schnittstelle muss vorhanden sein. Außerdem muss ein Barcodescanner mitgeliefert werden.

Interne Kennung: 08-2024

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 31720000 Elektromechanische Ausrüstung

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft

TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.4. Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft

Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen

Registrierungsnummer: t:089323540

Abteilung: Vergabestelle

Postanschrift: Isarauenweg 1

Stadt: Garching bei München

Postleitzahl: 85748

Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Land: Deutschland

E-Mail: ausschreibung@mpp.mpg.de

Telefon: 08932354217

Internetadresse: <https://www.hll.mpg.de/>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI

Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 2a71d94c-07d3-4e65-b83f-108f5cf3890b - 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder

Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 06/02/2024 00:00:00 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 79325-2024

